

## Veranstaltungshotel

Dorint-Hotel Frankfurt-Niederrad  
Hahnstraße 9  
60528 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 66306-0  
Fax +49 69 66306-600  
E-Mail [reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com](mailto:reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com)  
[www.dorint.com/de/hotel-frankfurt-niederrad](http://www.dorint.com/de/hotel-frankfurt-niederrad)



Wegbeschreibung Dorint Hotel

## Zimmer-Reservierung

Für Teilnehmer des Expertentreffens kann eine begrenzte Anzahl von Zimmern über das Abrufkontingent mit dem Stichwort „ZVEI-AVT“ direkt im Dorint-Hotel Frankfurt-Niederrad gebucht werden.

## Teilnahmegebühr

Die Veranstaltung ist kostenfrei.  
Die Teilnahme an der Tagesveranstaltung ist auf 80 Personen und die der Abendveranstaltung auf 50 Personen begrenzt.  
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  
Ihre Teilnahmebestätigung erhalten Sie per E-Mail.  
Bitte informieren Sie uns bis zum 12. Februar 2018, wenn Sie Ihre Teilnahme auf eine Ersatzperson übertragen möchten.

Änderungen des Programms vorbehalten.

## Anmeldung

- Ich nehme am AVT-Expertentreffen am 20. Februar 2018 teil.
- Ich nehme am Vorabendtreffen im Dorint-Hotel am 19. Februar 2018 teil.

Name

Firma

Straße, PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail



ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.  
Fachverband Electronic Components and Systems  
Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main

## Ihr Ansprechpartner beim ZVEI

Dr. Sven Baumann  
Telefon +49 69 6302-468  
E-Mail [baumann@zvei.org](mailto:baumann@zvei.org)



Einladung

## AVT-Expertentreffen

Konsum-Elektronik im Automobil –  
Möglichkeiten und Grenzen der Aufbau- und Verbindungstechnik

19./20. Februar 2018, Frankfurt am Main



Copyrights: Fotolia.com: DDrRockstar, Astrid Gast, alphadogdesign, FreedomImage, Sashkin, ThorstenSchmitt, Daniel Schweinert

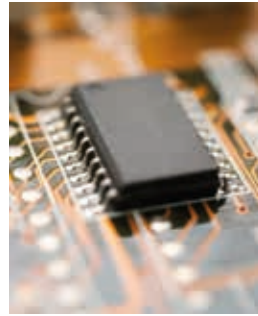
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie

# AVT-Expertentreffen Konsumelektronik im Automobil – Möglichkeiten und Grenzen der Aufbau- und Verbindungstechnik.

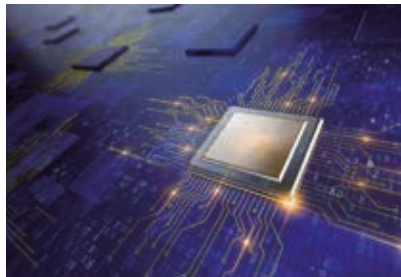
Dienstag, 20. Februar 2018, Frankfurt am Main

Auch im automobilen Sektor werden die „digitalen“ Innovationen aus der Konsumelektronik immer stärker vom Kunden gefordert.

Die Anforderung der Automobilindustrie nach einer „Null-Fehler-Strategie“ ist jedoch mit einer kostengünstigeren Konsumelektronik nicht möglich, da die benötigten Komponenten, wie Telefon-Module, GPS-Module, Kameras, Internetverbindungs-Module etc. für den Konsumbereich entwickelt werden.



Durch die Massenproduktion von Chips können in der Regel die Konsumelektronikkomponenten in den Grundstrukturen nicht geändert werden. Häufig besteht jedoch die Möglichkeit, mit der richtigen Wahl der Aufbau- und Verbindungstechnologie Schlüsselkomponenten aus dem Konsumbereich zu übernehmen. Daher ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Anwendung der Konsumelektronik im Automobil in der robusten Aufbau- und Verbindungstechnologie zu finden.



Mit neuen optischen Messverfahren besteht heute z. B. die Möglichkeit, Simulationen und Messungen von Chips, PCB und Gehäuse besser zu vergleichen (Auflösung 1  $\mu\text{m}$ ) und lokale Schwachstellen zu analysieren. Mit Hilfe dieses Systems können thermomechanische Verspannungen bei Chips, PCB und Gehäusen gemessen werden und damit Simulationen überprüft werden.



Im AVT-Expertentreffen am 20. Februar 2018 werden Methoden vorgestellt, die es u. a. erlauben, Design und Komponenten im Verbund mit PCB und Gehäuse erfolgreich zu optimieren. Es werden alternative und innovative Aufbau- und Verbindungstechnologien gezeigt, die eine erhöhte Zuverlässigkeit gegenüber unseren heutigen Standards besitzen.

## Programm

Montag, 19. Februar 2018

19:00 Uhr **Vorabendveranstaltung mit Vortrag Trends und Herausforderungen der AVT im Anwendungssegment „Automobile“**  
Andreas Aal, VW

Dienstag, 20. Februar 2018

- 9:00 Uhr **Begrüßung und**  
Dr. Reinhold Ortman, Continental Automotive France
- 9:20 Uhr **Main Challenges/Roadmaps in Packaging in Consumer, Industrial and Automotive Applications**  
Jean-Christophe Eloy, Yole Développement
- 9:50 Uhr **Fact Sheet – Truly Different: Automotive Semiconductor and Consumer Components**  
Stephan Lehmann, NXP Semiconductor
- 10:20 Uhr **Robustness Validation**  
Dieter Wagner, Continental Automotive
- 10:50 Uhr **Kaffeepause mit Gesprächen**
- 11:15 Uhr **Wie zuverlässig sind Zuverlässigkeitsprognosen an Konsumer Komponenten für den automobilen Einsatz?**  
Prof. Dr. Sven Rzepka, Fraunhofer ENAS
- 11:45 Uhr **Vergleich optische thermomechanische Spannungsanalyse mit Simulation**  
Dr. Rainer Dudek, Fraunhofer ENAS
- 12:15 Uhr **Mittagessen**
- 13:15 Uhr **Optische thermomechanische Spannungsanalyse an Leiterplatte und Montage**  
Dr. Thomas Fries, FRT
- 13:45 Uhr **Laserschweißen erhöht die AVT-Zuverlässigkeit**  
Christan Braun, Continental Automotive
- 14:15 Uhr **Kaffeepause mit Gesprächen**
- 14:40 Uhr **AVT bei Druckensoren**  
Dr. Tim Behrens, Robert Bosch
- 15:10 Uhr **Neue Mikro-Verbindungen mit Nano-Klettverschlüssen**  
Prof. Dr.-Ing. Helmut Schlaak, Nano Wired
- 15:40 Uhr **Kaffeepause mit Gesprächen**
- 16:00 Uhr **Ende**